

RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ассортимент продукции включает следующие модели:

- 90°, лежащая (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
- Защелка верх / защелка вниз;
- Технология пайки THT или THR
- Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и печатными площадками для экранирования
- Категория эксплуатационных характеристик от кат. 3 до кат. 6
- Упаковка – лоток (TY) или рулон (лента на катушке, RL)
- Совместимость с модульным разъемом RJ45 в соответствии со стандартами ANSI/TIA-1096-A и IEC 60603
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В пер. тока, среднеквадратичное значение (2250 В пер. тока, амплитудное значение) в соответствии со стандартом IEEE 802.3
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В перем. тока (амплитудное значение) или ≥ 1500 В пост. тока в соответствии со стандартом с IEC 60603

Особенности и преимущества:

- Расширенный диапазон температур: от -40 до $+85$ °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик

- Слой золота повышенной прочности (30 мкм) для улучшения защиты от коррозии
- Расстояние по меньшей мере 0,3 мм обеспечивает отличный результат пайки

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5, Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 μ m Ni / ≥ 30 μ m Au, Светодиод: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 12, Tape
Номер для заказа	2562870000
Тип	RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL
GTIN (EAN)	4050118571790
Кол.	200 Шт.
Упаковка	Tape

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:27:02 CEST

RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	15,8 мм	Высота (в дюймах)	0,622 inch
Высота, мин.	13,6 мм	Глубина	21,5 мм
Глубина (дюймов)	0,846 inch	Масса нетто	10 g
Ширина	15,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,622 inch

Упаковка

Упаковка	Tape	Длина VPE	0 м
VPE с	0 м	Высота VPE	0 м
Диаметр катушки с лентой $\varnothing$ (A)	330 mm	Поверхностное сопротивление	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$

Системные характеристики

Вид защиты	IP20	
Вид соединения	Гнездо	
Выводы для экранирования	6 tabs	
Диаметр монтажного отверстия (D)	0,9 мм	
Длина контактного штифта (l)	3,2 мм	
Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)	±0,1 мм	
Допуск на длину выводов под пайку	Нижний допуск с префиксом (показывает минимум)	-0,5
	Верхний допуск с префиксом (показывает максимум)	+0,5
	Допуск, единица	mm
Допуск на длину выводов под пайку	+0,5 / -0,5 mm	
Категория	Cat. 5	
Категория эксплуатационных характеристик	Cat. 5	
Количество контактных штырьков на полюс	1	
Количество полюсов	12	
Материал экрана	Латунь	
Монтаж	8-жильный	
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	
Поверхность экрана	никелированный	
Светодиод	Да	
Серия изделия	Данные OMNIMATE – модульный штекер RJ45	
Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную, Пайка волной припоя	
Угол вывода	90°	
Фиксатор — опция	снизу	
Цвет левого светодиода	зеленый	
Цвет правого светодиода	желтый	
Шаг в дюймах (P)	0,05 inch	
Шаг в мм (P)	1,27 мм	
Экранирование	Да	

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51
---------------------------	----------------

RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Электрические свойства

Номинальное напряжение	125 V	Номинальный ток	1,5 A
Электрическая прочность, контакт / контакт	1000 V AC		

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 9T	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	II
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал контактов	Фосфористая бронза
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Структура слоев штепсельного контакта	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	85 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E471884

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------

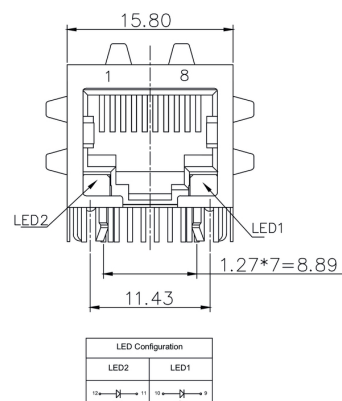
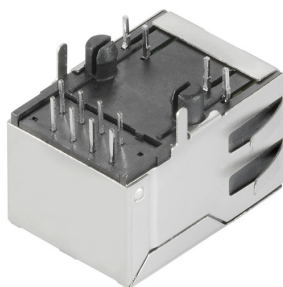
RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

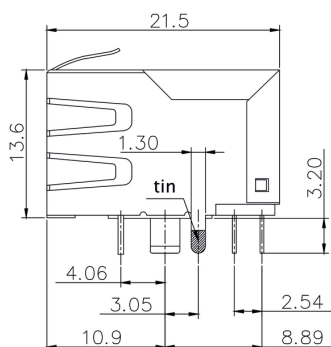
www.weidmueller.com

Изображения

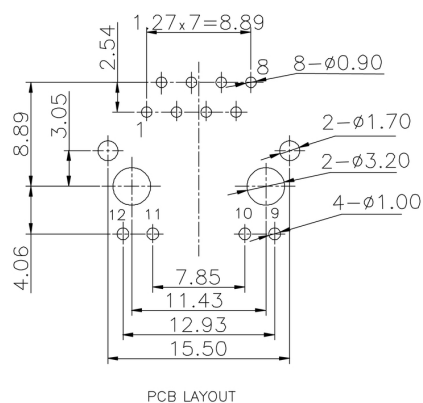
Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Чертеж РСВ платы



RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

RJ45	G1	R1	U1	U2	E4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
							Packaging	TY RL Tay in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)
							LED	Y/G G/Y GY/GY O/O R/O ... N Yellow/Green Green/Yellow (standard) Yellow/Green-Yellow Orange-Green Red/Orange ...(further combinations possible) without LED
							Contact surface thickness	4 1 = 3µ, 2 = 6µ, 3 = 15µ, 4 = 30µ, 5 = 50µ
							EMI tabs (ground fingers)	E N E = with EMI tabs N = without EMI tabs
							Solder Pin length	3.2 1.6 D 3.2 mm 1.6 mm SMD
							Direction, latch style	U D V Y Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up
							Number of Ports	1 Port 12; 14; ... 21; 41; ... multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel
							Assembly on PCB	R S T Through Hole Reflow - THR Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave
							Performance Category	C5 C6 C6A C5e M G1 G10 U MP MP+ Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+

Условные обозначения

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:27:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.